

化合物耗材

瑞斯普提供了居多化合物产品广泛应用于
各个光学领域：

- 视光学
- 半导体
- 精密光学
- 金属表面加工

想要更多细节请联系我们：

www.rspycl.com

sales@rspycl.com



树脂镜片抛光液

- 氧化铝制品
- 高端工艺合成，粒度控制优异
- 多种化合物配比，不同规格对应不同产品及工艺

产品参数

POLISH	PH	D50(um)	Baume	Volume	Package	Order No.
All Format	3.0-3.8	2.0±0.2um	26±1°	1 Gallon	4 Bottles	R6018
Tradional Plus	3.3-3.8	2.0±0.2um	-	1 Gallon	4 Bottles	757
Digital Advanced	3.4-3.8	2.0±0.2um	19±1°	1 Gallon	4 Bottles	R6009
All Format Pro	3.0-3.8	2.0±0.2um	26±1°	1 Gallon	4 Bottles	6025T



全新一代树脂镜片抛光液

- 全新工艺融合氧化铝原料
- 更加适合高折1.67、1.74及pc镜片的加工
- 有效解决高折镜片抛光过程易划伤的问题

产品参数

POLISH	PH	D50(um)	Baume	Volume	Package	Order No.
SKG-ALL	3.4-3.8	1.8±0.2um	23±1°	1 Gallon	4 Bottles	757-1S



切削液

- 镜片铣磨用产品
- 降低产品加工后表面粗糙度
- 抑制设备核心部件生锈，提升刀具寿命



清洗剂

- 树脂镜片清洗剂
- 多个产品规格适用于各个清洗工艺
- 不含磷，不含重金属，符合ROHS

蓝宝石抛光液

· 该系列产品为碱性抛光液，采用改性氧化铝主要原料，辅以化学助剂。在严格控制粒径、改善粒子表面特性的基础上所开发的一款新产品；与氧化硅抛光液相比，本品使用简便、抛光表面易清洗、无抛光设备腐蚀、表面质量优于氧化硅抛光液。

规格参数

产品名称	PH	D50(um)	订购型号
蓝宝石衬底抛光液	>12	1.0-1.3	RSC-6903
蓝宝石窗口抛光液	>12	1.0-1.3	RSC-6913

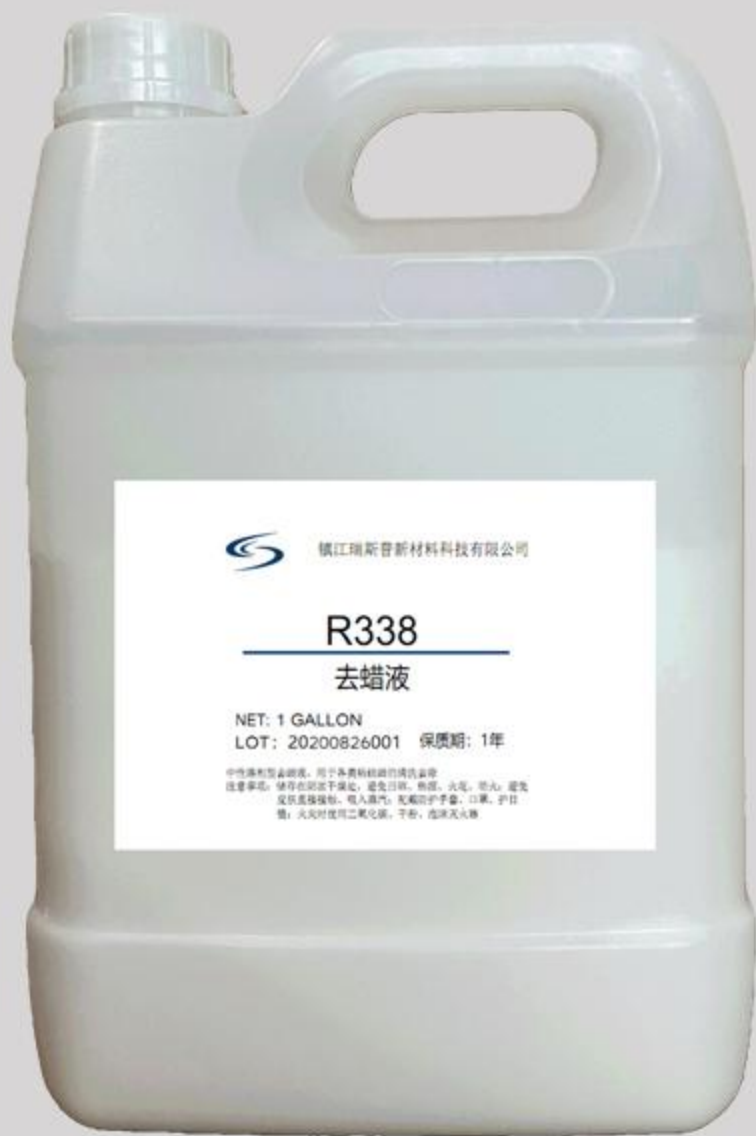
碳化硅抛光液

· 该系列产品为碱性抛光液，采用二氧化硅主要原料，辅以化学助剂。在严格控制粒径、改善粒子表面特性的基础上所开发的一款新产品；与传统抛光液相比，本品使用简便、抛光表面易清洗、无抛光设备腐蚀、表面质量优。

规格参数

产品名称	粒度 (nm)	D50 (um)	pH	订购型号
碳化硅衬底抛光液	60-80		>10	RSC-3201
碳化硅衬底抛光液		1.0-1.3	<3	RSC-6905





去蜡液

·该系列产品，适用于半导体芯片、蓝宝石、石英等材质粘结蜡去除，环保、安全、气味低。

产品参数

产品名称	清洗对象	订购型号	备注
去蜡液	半导体芯片（氮化镓、砷化镓、磷化铟等）	R338	油性去蜡液
去蜡液	半导体芯片（氮化镓、砷化镓、磷化铟等）	R339	油性去蜡液气味极低



研磨助剂/悬浮剂

·悬浮剂/研磨助剂系列产品，包括碳化硼、氧化铈、氧化铝等粉体，加工对象为蓝宝石、蓝玻璃、砷化镓等材质

产品参数

规格型号	适用粉体	加工对象	备注
RX533/R528	碳化硼	蓝宝石	双组分悬浮剂（循环型）
RX5100	氧化铝/氧化锆	砷化镓	混粉体系，用于半导体芯片减薄
RX5106	氧化铈	玻璃	稀土抛光粉用研磨助剂

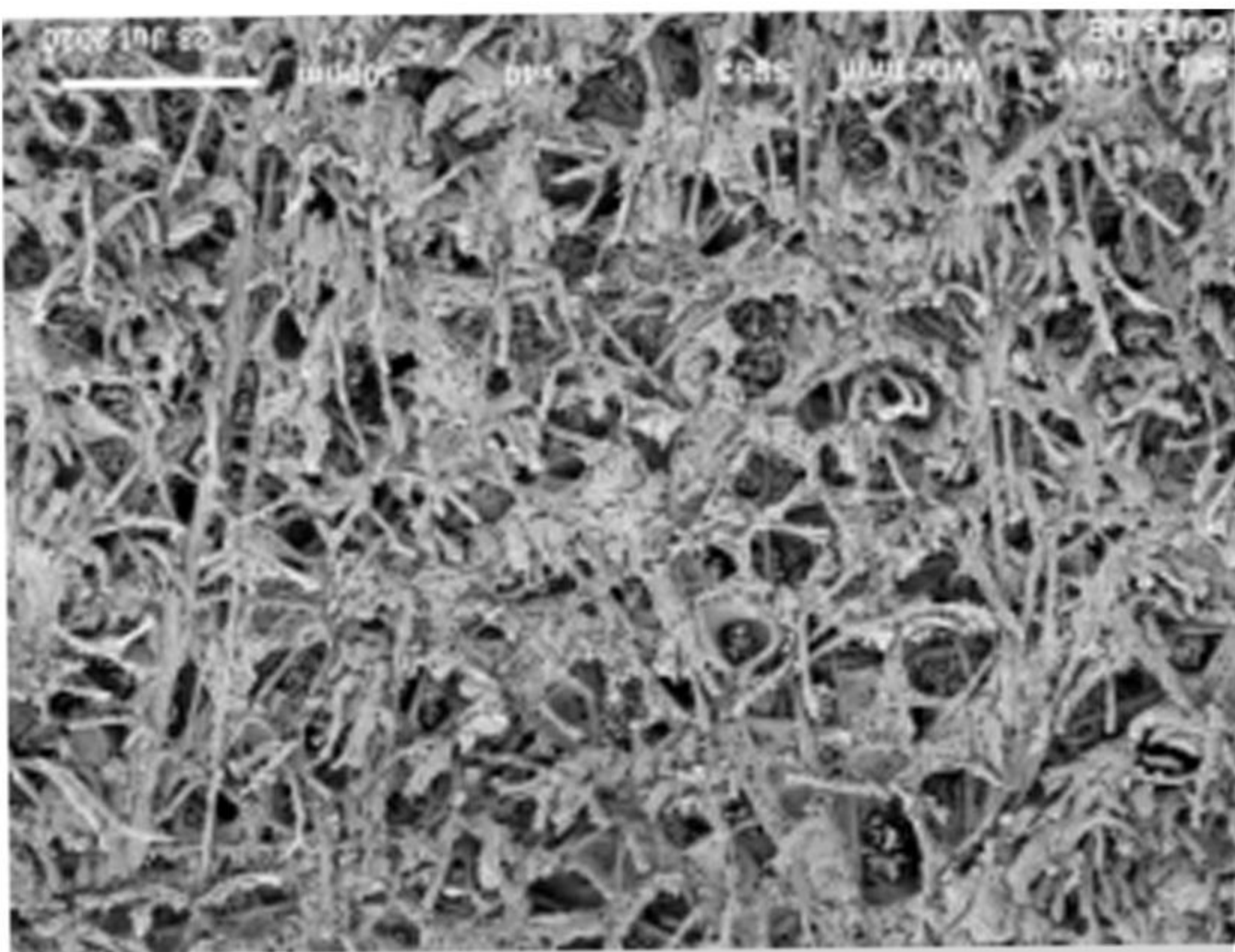


SH-P60A 粗抛垫

SH系列抛光垫，原材料采用进口高性能原皮，本产品含有特殊硬质材料及纤维结构，能在研磨抛光期间达到最佳移除率以及平坦化效果，用于粗、中抛阶段的工艺需求。适用于硅晶圆、再生晶圆、各类III-V族或II-VI族等晶圆，如蓝宝石、砷化镓、氮化铝与碳化硅等材质的抛光工艺。

规格参数

	Measure Value
Thickness(mm)	1.39
Density (g/cm³)	0.463
Compressibility(%)	5.1
Rebound(%)	81.35
Hardness(Shore A)	74.2
Adhesive Peel Strength Dry / Wet (kgf/cm²)	0.6 ↑ / 0.45 ↑

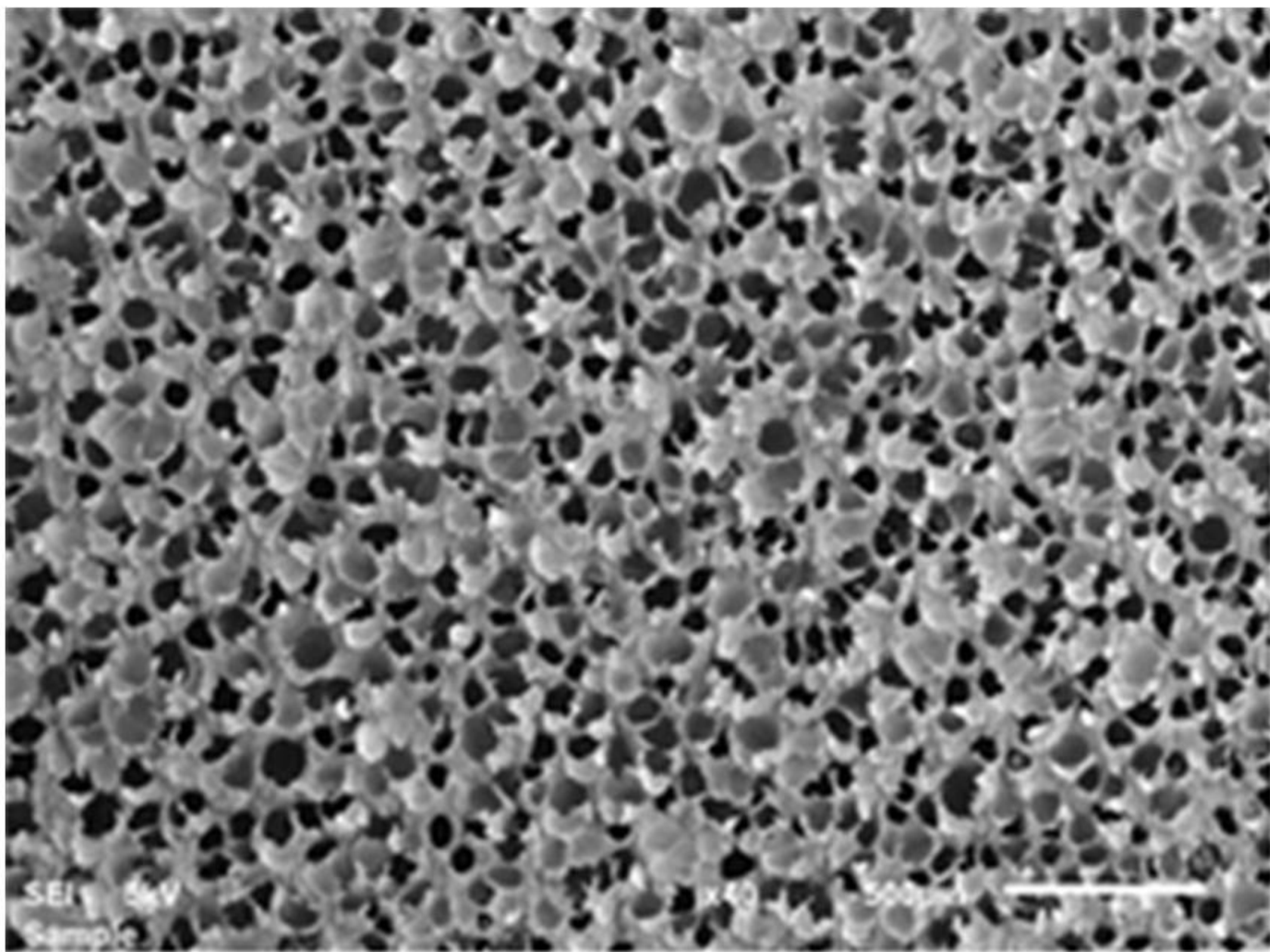


SP-FP1452 精抛垫

GP/SP系列抛光垫，原材料采用进口高性能原皮，使用精密控制的表层涂布技术，制成微米孔隙表层与底层缓冲结构，提供绝佳复合材料比。产品表层微米孔径均匀分布，能承载所需抛光液及提供抛光后副产物排出特性。广泛用于碳化硅、硅片等产品的最终抛光。

规格参数

ITEM	SP-FP1452
	Measure Value
Thickness(mm)	1.65
Density (g/cm³)	0.43
Compressibility(%)	10.98
Elasticity(%)	94.37
Hardness(Shore A)	51.0
Pore Size (μm)	57





不锈钢制品抛光液

·该系列产品为酸性抛光液，采用高温煅烧氧化铝主要原料，辅以化学助剂。在严格控制粒径、改善粒子表面特性的基础上所开发的一款新产品；本品使用简便、研磨效率高，易清洗、无抛光设备腐蚀。

产品参数

产品名称	PH	D50 (um)	产品型号
不锈钢粗抛液	3-4	2.5-3.5	RSC-6612
不锈钢精抛液	3-4	1.0-1.3	RSC-6602



铝合金抛光液

·该系列产品为碱性抛光液，采用高温煅烧氧化铝主要原料，辅以化学助剂。在严格控制粒径、改善粒子表面特性的基础上所开发的一款新产品；本品使用简便、研磨效率高，易清洗、无抛光设备腐蚀。

产品参数

产品名称	PH	D50 (um)	产品型号
铝合金粗抛液	9-10	2.5-3.5	RSC-6613
铝合金精抛液	9-11	1.0-1.3	RSC-6603



抛光液

· 该系列产品采用改性纳米氧化铝主要原料，辅以化学助剂。在严格控制粒径、改善粒子表面特性的基础上所开发的一款新产品；与传统抛光液相比，本品使用简便、抛光表面易清洗、无抛光设备腐蚀。表面质量优于传统稀土抛光液。

产品参数

产品名称	PH	D50(um)	订购型号
蓝玻璃抛光液	8-10	0.3-0.4	RSC-6302
蓝玻璃中抛液	8-10	1.0-1.5	RSC-6312
光学软材质中抛液	8-10	1.0-1.5	RSC-6313
光学软材质抛光液	8-10	0.3-0.4	RSC-6303
红外晶体抛光液	6-7	0.3-0.4	RSC-6301
红外晶体中抛液	6-7	0.7-1.2	RSC-6311



蓝玻璃抛光粉R系列

· 稀土制品。根据不同晶体供应商的产品特性，提供多种粒度及化合物配比方案，适合所有蓝玻璃加工工艺需求。

产品参数

产品名称	PH	D50(um)	订购型号
蓝玻璃抛光粉	8-10	10-12	R系列



精密光学/红外材料清洗液

· 瑞斯普水性清洗剂系列产品主要针对树脂镜片、光学玻璃、红外晶体/玻璃等材质，用于清洗抛光液、油污、指纹等

产品参数

产品名称	PH	加工对象	订购型号
清洗液	12-13	树脂镜片、玻璃模具	RW10系列
蓝玻璃抛光粉	6-8	蓝玻璃、红外材料	R340
蓝玻璃抛光粉	12-13	蓝玻璃、红外材料	R334





红外晶体·光学玻璃产品

·包括抛光粉、抛光液、抛光垫、清洗液等，部分原料采用高性能进口原材，具有较高的性价比，可以根据客户需求做出调整，适用于各种磨耗度的光学玻璃、红外晶体、激光晶体等行业。

产品分类	产品系列	产品说明
抛光垫	氧化铈抛光垫	性能类似于LP66&LP88 满足低、中及高M磨耗度光学玻璃抛光需求，适用于光学镜头、光学棱镜、盖板玻璃及水晶等光学元件平面抛光需求。
	阻尼布抛光垫	性能类似于Politex、Fujibo等阻尼布 适用于红外晶体及中高磨耗度光学玻璃的最终镜面抛光。
抛光粉 抛光液	稀土抛光粉R系列	瑞斯普稀土抛光粉R系列产品，包括纯铈粉、镧铈粉、含锆抛光粉（红粉），适用于光学镜头、光学棱镜、盖板玻璃及水晶等光学元件平面抛光需求。
	氧化铝RSC-6系列抛光液	瑞斯普精抛液系列产品，适用于蓝玻璃、红外晶体、光学软材质及超软材质等产品的终抛工艺。
其他	研磨剂/悬浮剂	系列产品，包括液体双组分、固体单组分研磨剂/悬浮剂，适用于碳化硅、稀土抛光粉等粉体，可用于光学玻璃的研磨、减薄工艺。
	清洗剂	包括光学玻璃，红外激光晶体的清洗液，环保、安全、性价比高。

抛光粉系列

名称	型号	D50 (um)	D100 (um)	应用领域
镧铈抛光粉	R308A	0.8-1.0	<4	一般光学加工
	R312A	1.1-1.5	<10	一般盖板加工、光学加工
	R311A	1.0-1.3	<6	光学硬材
	R322A	1.8-2.2	<13	光学硬材
纯铈抛光粉	R308	0.8-1.0	<4	蓝玻璃粗抛
	R316	1.3-1.8	<10	一般光学加工
少钕抛光粉	R378	0.8-1.0	<4	光学软材
	R376	1.1-1.5	<10	光学软材
	R366	1.1-1.5	<10	光学硬材